

# GJS01/GPJ01-H型卧式光缆接头盒 288芯光缆哈味式接续盒 室外防水光缆接续包 双端接头包

产品名称	GJS01/GPJ01-H型卧式光缆接头盒 288芯光缆哈味式接续盒 室外防水光缆接续包 双端接头包
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PTTP普天泰平 型号:GJS01/GPJ01立式/卧式 产地:浙江.宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

## 产品详情

GJS01/GPJ01-H型卧式光缆接头盒 288芯光缆哈味式接续盒 室外防水光缆接续包 双端接头包

「PTTP普天泰平&GJS01系列通信光缆接续盒|接头盒/接续包」光缆接头盒|GJS01型光缆接头盒|GPJ01系列光缆接续盒（opticalcable connect,jointbox）【（哈味式/卧式）（炮筒式/立式）】光缆接线盒,光缆接续盒,光缆接续包,光缆接头包规格（12芯,24芯,48芯,72芯,96芯,144芯,288芯）光缆接头盒是通俗的叫法,学名叫光缆接续盒,又称光缆接续包,光缆接头包和炮筒,主要是在适用于各种结构光缆的架空,管道,直埋等敷设方式之直通和分支连接。盒体采用进口增强塑料,强度高,耐腐蚀,终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续,结构成熟,密封可靠,施工方便。广泛用于通信,网络系统,CATV有线电视,光缆网络系统等等。

光缆接头盒是根据通信标准专业设计用以保护光纤接续点的产品,泰平通信提供全规格,多种类的光缆接头盒,旗下产品卧式光缆接头盒与帽式光缆接头盒可用以地理,架空,管道,人井等多种场合,防护等级达到IP65。

GJS01/GPJ系列卧式光缆接头盒（哈味式）

光缆接头盒是对光缆的接续提供可靠保护的无源设备。光缆接头盒由接头盒罩、固定组件、接头盒密封组件以及余纤收留盘四部分构成。

## 产品特点

可提供光缆的直通、分歧、熔接功能

适用于架空、和管道人井壁挂以及直埋安装

内装层叠式熔接盘，开启方便，可以取下操作，便于线路安装及维护

选择熔接盘，适合带状光纤或集成束状光纤，可在大容量内任意配置

走纤规范，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于30mm

## 订货信息

名称

型号

规格

满配容量

密封方式

光缆进出口数

适用缆径

安装方式

高 × 宽 × 深 ( mm )

束状

带状

GJS01/GPJ01型光缆接头盒（卧式）

GJS-01A

474 × 222 × 124

96

144

机械密封

2进2出

8-16mm

架空、壁挂、直埋

GJS-01B

388 × 185 × 104

96

144

机械密封

3进3出

4孔： 8-13mm

2孔： 8-16mm

架空、壁挂

GJS-01C

560 × 245 × 180

384

432

机械密封

8进8出

2孔： 2-23mm

2孔： 2-20mm

4孔： 4-16mm

8孔： 8-14mm

GJS-01D

455 × 180 × 120

96

--

机械密封

2进2出

10-17.5mm

GPJ-01A

474 × 201 × 150

144

432

机械密封

2进2出

10-20mm

GPJ-01B

460 × 180 × 108

96

--

机械密封

2进2出

7-18mm

## GJS01/GPJ系列帽式光缆接头盒

光缆接头盒主要适用于架空光缆、直埋光缆、管道井光缆的直通和分歧接头，对接头起保护作用。

### 产品特点

可提供光缆的直通、分歧、熔接功能

适用于架空、管道人井壁挂以及抱杆安装

内装层叠式熔接盘，开启方便，可以取下操作，便于线路安装及维护

选择熔接盘，适合带状光纤或集成束状光纤，可在大容量内任意配置

走纤规范，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于30mm

### 产品特点

可提供光缆的直通、分歧、熔接功能

适用于架空、管道人井壁挂以及抱杆安装

内装层叠式熔接盘，开启方便，可以取下操作，便于线路安装及维护

选择熔接盘，适合带状光纤或集成束状光纤，可在大容量内任意配置

走纤规范，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于30mm

### 产品特点

可提供光缆的直通、分歧、熔接功能

适用于架空、管道人井壁挂以及抱杆安装

内装层叠式熔接盘，开启方便，可以取下操作，便于线路安装及维护

选择熔接盘，适合带状光纤或集成束状光纤，可在大容量内任意配置

走纤规范，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于30mm

订货信息

名称

型号

规格

满配容量

密封方式

光缆进出口数

适用缆径

安装方式

高×宽×深（mm）

束状

带状

GJS01/GPJ01系列光缆接头盒（帽式）

GJS-M01

435×190

96

--

热缩密封

1直通3分歧

分歧孔： 8-16mm

直通孔： 8-25mm

架空、壁挂、抱杆

GJS-M02

598 × 285

960

--

机械密封

1直通8分歧

分歧孔： 8-22mm

直通孔： 8-23mm

GPJ-M01

450 × 230

144

432

机械密封

1直通4分歧

分歧孔： 8-18mm

直通孔： 8-18mm

GPJ-M02

520 × 245

96

--

机械密封

1直通4分歧

分歧孔： 5-17.5mm

直通孔： 8-17.5mm

GPJ-M03

460 × 230

144

432

热缩密封

1直通4分歧

分歧孔： 7-22mm

直通孔： 7-22mm



AMD Radeon Instinct MI60集成64个计算单元、4096个流处理器，提供的是32GB的HBM2 ECC显存，拥有14.7T的FP32性能，7.4T的FP64性能，其中浮点性能将会是Vega架构的MI25的2.8倍。

AMD Radeon Instinct

MI50则集成60个计算单元、3840个流处理器，相比MI60性能方面略有降低。提供16GB的HBM2 ECC显存，拥有13.4T的FP32性能，6.7T的FP64性能。

MI60/MI50两者都支持PCI-E 4.0、双链路Infinity Fabric，提供1TB/s显存带宽，热设计功耗均为300W。AMD称MI60/50计算卡将会使用“无限带宽”的技术进行连接，提供200GB/S点对点带宽速度，是PCI-e 3.0的速度的6倍。

AMD还公布了ROCm 2.0，一款专为加速运算而生的开源软件平台的新版本，包括了新的数学库、更广泛的软件框架支持和优化的深度学习运行。

为未来布局：Zen2即将发布，Zen3、Zen4核心架构已提上日程

AMD意识到要回到服务器及数据中心市场就必须新的CPU核心上进行长期的投资，Zen架构也奠定了AMD未来几年产品的路线图。这是AMDgaoji副总裁兼数据中心与嵌入式解决方案事业部总经理Forrest Norrod在去年Computex上说过的话。

即将推出的“Zen 2”高性能x86 CPU处理器核心，该模块化系统设计采用AMD Infinity Fabric互联的增强版本，在单个处理器封装内链接多片独立的硅晶片(“chiplets”)。

Zen2 CPU核心采用了7nm制程技术，而芯片的I/O部分则采用14nm制程技术，因为后者大部分都是模拟电路，7nm技术不会对其有明显改善，而且混合工艺模块组合的方式还节省了成本，性价比更高。这种混合工艺的全新设计方法，与台积电7nm制程技术相结合，带来了性能、电量消耗和密度的巨大提升。

另外，在前后端改进方面，Zen2有更优良的分支预测器，更出色的指令预取，重新优化的指令缓存和更大的运行缓存;在浮点方面，浮点宽度翻倍，增至256 bit，载入/存储带宽翻倍，增加了分发/收回带宽，所有模式都能够保持高吞吐量;在安全方面，硬件增强的Spectre(幽灵)漏洞修复，采用软件迁移并强化在设计中，同时增加了内存加密的灵活性。